भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 62

जिसका उत्तर 2 फरवरी, 2022 को दिया जाना है।

13 माघ, 1943 (शक)

डीएलआई योजना

62. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :
श्री रवि किशन :
श्री रविन्दर कुशवाहा :
श्री सुधीर गुप्ता :
श्री प्रतापराव जाधव :
श्री मनोज तिवारी :
श्री सुब्रत पाठक :
श्री बिद्युत बरन महतो :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर चिप विकसित करने के लिए उसकी डिजाइन-सम्बद्ध प्रोत्साहन राशि (डीएलआई) योजना के लिए हाल ही में स्वदेशी कंपनियों, स्टार्ट-अपों और विभिन्न एमएसएमई इकाइयों से आवेदन मांगा/आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार को इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है ?

(ग) डिजाइन-सम्बद्ध प्रोत्साहन राशि योजना के उद्देश्यों और लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किटों, चिपसेटों, चिप सिस्टमों, अन्य सिस्टमों और आईपी कोर तथा सेमीकंडक्टर जैसे डिजाइन के निर्माण में शामिल घरेलू कंपनियों को प्रदान की जाने वाली संभावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार का उक्त घरेलू कंपनियों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी विचार है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त योजना के तहत प्रोत्साहन राशि और लाभ प्राप्त करने के लिए सेमीकंडक्टर निर्माण में शामिल घरेलू कंपनियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क): जी, हाँ । एमईआईटीवाई ने डिजाइन संबद्ध प्रोहत्साहन (डीएलआई) योजना की घोषणा की है और देश में सेमीकंडक्टर चिप्स विकसित करने के लिए घरेलू कंपनियों , स्टार्ट -अप और एमएसएमई से योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं।

(ख) और **(ग):** डीएलआई योजना का लक्ष्य इन उद्देश्यों के साथ 5 वर्षों की अवधि में इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी), चिपसेट , सिस्टम ऑन चिप्स (एसओसी), सिस्टम और आईपी कोर और सेमीकंडक्टर लिंक्ड डिजाइन के के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन के विकास और तैनाती के विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता के साथ -साथ डिजाइन बुनियादी ढांचा समर्थन प्रदान करना है :

(i) इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी), चिपसेट , सिस्टम ऑन चिप्स (एसओसी), सिस्टम और आईपी कोर और सेमीकंडक्टर लिंक्ड डिज़ाइन के लिए सेमीकंडक्टर डिज़ाइन की 100 घरेलू कंपनियों का पोषण करना और अगले 5 वर्षों में 1500 करोड़ रु. से अधिक का टर्नओवर प्राप्त करने के लिए ऐसी 20 से कम कंपनियों के विकास को सुविधाजनक बनाना ।

(ii) देश में तैनात सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और आईपी में महत्वपूर्ण स्वदेशीकरण प्राप्त करना , जिससे अगले 5 वर्षों में इलेक्ट्रॉनि की क्षेत्र में आयात प्रतिस्थापन और मूल्यवर्धन की सुविधा हो।

(iii) सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए इन्क्यूबेटरों के माध्यम से डिजाइन अवसंरचना ढांचे को सुदृढ़ करना और स्टार्टअप्स और एमएसएमई तक अभिगम की सुविधा प्रदान करना।

01 जनवरी , 2022 के बाद से आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक समर्पित डीएलआई वेब -पोर्टल **www.chips-dli.gov.in** विकसित किया गया है। आवेदन शुरू में 31 दिसंबर , 2024 तक आमंत्रित किए जाएंगे ।

घरेलू कंपनियों , स्टार्टअप्स और एमएसएमई के कुल 41 आवेदकों ने डीएलआई वेब -पोर्टल पर पंजीकरण कराया है और पूर्ण आवेदन जमा करने के विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) और **(ङ.):** डीएलआई योजना का उद्देश्य निम्नलिखित विवरणों के अनुसार उनके सेमीकंडक्टर डिजाइनों के विकास और तैनाती के विभिन्न चरणों में अनुमोदित आवेदकों को वित्तीय सहायता के साथ -साथ डिजाइन अवसंरचना सहायता प्रदान करना है :

वित्तीय सहायता :

(i) उत्पाद डिजाइन संबद्ध प्रोत्साहन - प्रति आवेदन 15 करोड़ रु. की सीमा के अध्यधीन पात्र व्यय के 50% तक की प्रतिपूर्ति अनुमोदित आवेदकों को उनके सेमीकंडक्टर डिजाइनों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी जिसे एक परिचालन वातावरण में प्रदर्शित किया जा सकता है और मात्रा उत्पादन के लिए तैयार हैं ।

(ii) डिप्लॉयमेंट संबद्ध प्रोत्साहन - प्रति आवेदन 30 करोड़ रु. की सीमा के अध्यधीन, 5 वर्षों में निवल बिक्री टर्नओवर के 6% से 4% की प्रतिपूर्ति , उन अनुमोदित आवेदकों को प्रदान की जाएगी जिनके सेमीकंडक्टर डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में तैनात हैं।

डिजाइन अवसंरचना सपोर्ट : सी -डैक (प्रगत संगणन विकास केन्द्र),एक साइंटिफिक सोसाइटी, जो इलेक्ट्रॉनि की और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित है, अनुमोदित आवेदकों को उनके सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइन करने के लिए डिजाइन अवसंरचना तक अभिगम की सुविधा प्रदान करेगा। डिजाइन के बुनियादी ढांचे में - ईडीए टूल्स , आईपी कोर और सेमीकंडक्टर फाउंड्री और पोस्ट -सिलिकॉन सत्यापन समर्थन में एमपीडब्ल्यू (मल्टी प्रोजेक्ट वेफर) तरीके से डिजाइन के प्रोटोटाइप के लिए समर्थनशामिल होंगे ।

(च): डीएलआई योजना के तहत वित्तीय सहायता घरेलू कंपनियों , स्टार्टअप्स और सेमीकंडक्टर डिजाइन में लगी एमएसएमई को दी जाएगी , जिसमें ;

(i) घरेलू कंपनियों को उन कंपनियों के रूप में परिभाषित किया जाएगा जिनका स्वामित्व निवासी भारतीय नागरिकों के पास है , जैसा कि 2017 के एफडीआई

नीति परिपत्र या मौजूदा मानदंडों में परिभाषित किया गया है।

(ii) एमएसएमई को सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय , या मौजूदा मानदंडों द्वारा दिनांक 1 जून 2020 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार परिभाषित किया जाएगा।

(iii) स्टार्टअप्स को दिनांक 19 फरवरी 2019 की डीपीआईआईटी अधिसूचना या मौजूदा मानदंडों के अनुसार परिभाषित किया जाएगा ।

****